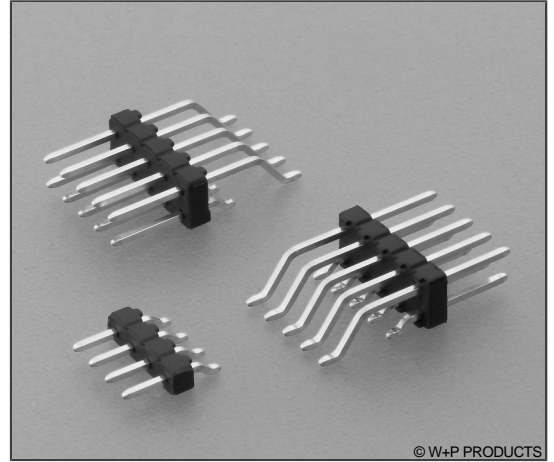


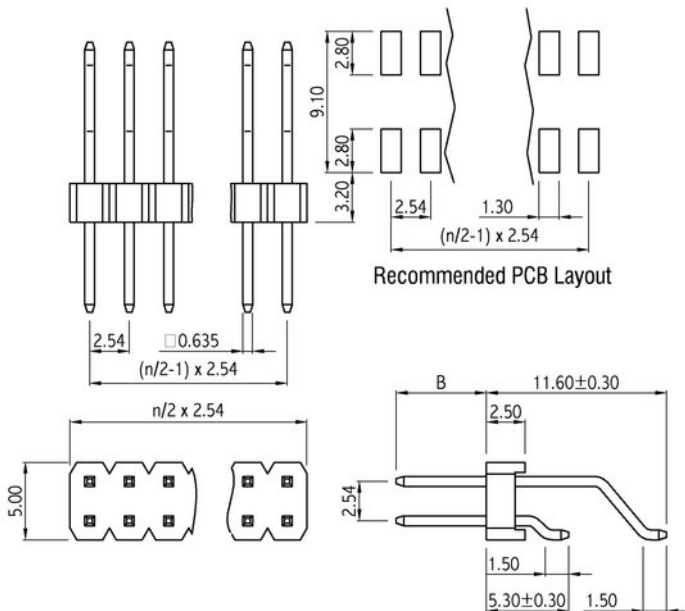
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.635mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV <sub>DC</sub>
Test Voltage	1kV <sub>DC</sub>
Nennspannung	250V <sub>AC</sub>
Voltage Rating	250V <sub>AC</sub>
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Compatible Female Headers:  
**1531 1532 3490 3491** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
Please see ch. B for more



Series	Dimensions*	Contacts*	Plating*	Packaging*
<b>3131</b>	<b>12</b>	<b>020</b>	<b>50</b>	<b>PPST</b>
<b>Thermisch gerissene Kontakte</b> <i>Electro-strictioned contacts</i> <b>3131</b> Zweireihig <i>Double row</i>	<b>95</b> B=4,00mm <b>11</b> B=5,30mm <b>12</b> B=5,80mm <b>13</b> B=7,10mm <b>14</b> B=8,40mm	<b>004-100</b> Zweireihig <i>Double row</i>	<b>00</b> Vergoldet <i>Gold plated</i> <b>10</b> 0,25µm Gold <i>0.25µm gold plated</i> <b>50</b> Verzinkt <i>Tin plated</i> Weitere Veredelungsoptionen auf Anfrage <i>More plating options on request</i>	<b>ST</b> <b>PPST</b> <b>PPTR (Option)</b>

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

**Lieferformen / Packaging Options:**  
**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*  
**PPTR (Option)** Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

